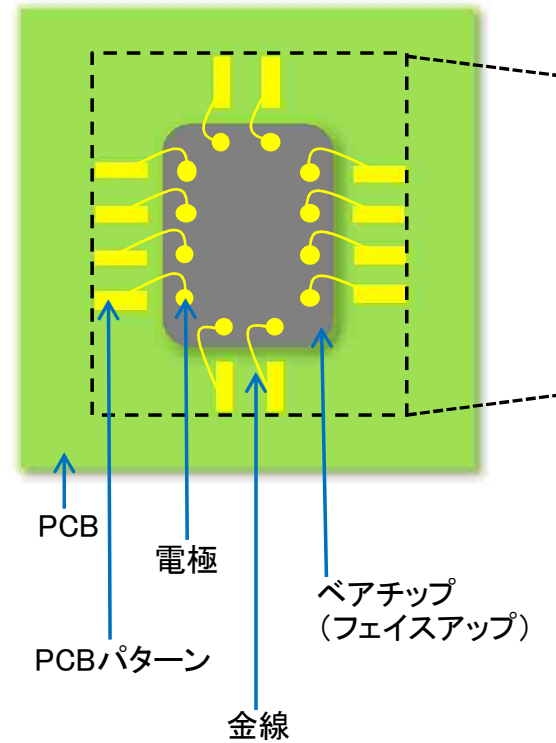
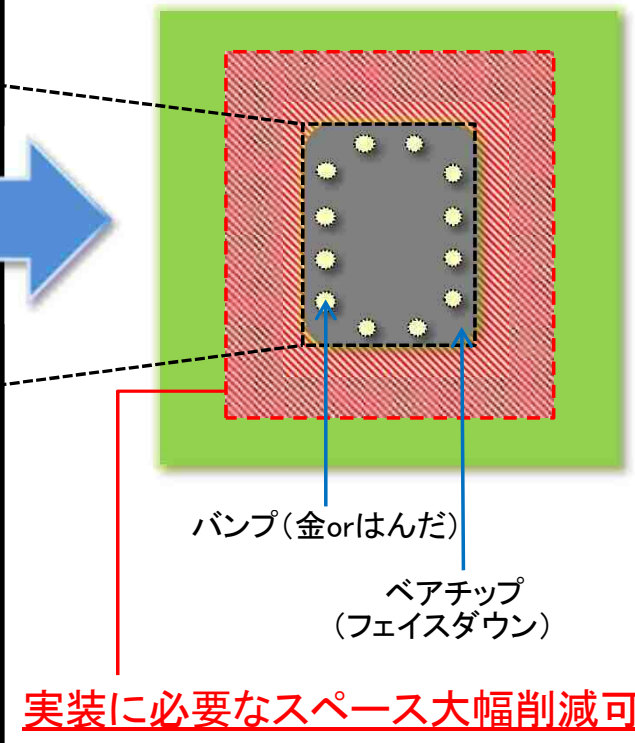


展示No	区分	<input checked="" type="checkbox"/> 部品加工(電子部品実装) <input type="checkbox"/> 表面処理 <input type="checkbox"/> 素材/材料 <input type="checkbox"/> 設備/装置 <input type="checkbox"/> 金型/治工具 <input type="checkbox"/> システム/ソフトウェア <input type="checkbox"/> デザイン <input type="checkbox"/> 自動化技術 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 医療ヘルスケア <input type="checkbox"/> 環境エネルギー <input type="checkbox"/> 航空宇宙 <input type="checkbox"/> 地域連携等		
	18	提案名	工法	新規性
会社名	アイデアシステム(株)		C4接合、US接合	業界先端
連絡先	所在地 〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-1-21		URL : http://www.idea-gr.co.jp/	
部署名 : 本社営業部	Tel No. : 0266-24-2744		E-mail : y.sato@idea-gr.co.jp	
担当名 : 佐藤 雄一	海外対応		生産拠点を記入	
主要取引先	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否	
	・セイコーエプソン(株) ・大研医器(株) ・三菱重工業(株) ・TDK(株) ・キーサイト・テクノロジー ・(株)東芝			

<< 提案内容 >>

提案の狙い	適用可能な製品/分野				
<input type="checkbox"/> 原価低減 <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 <input checked="" type="checkbox"/> 質量低減 <input type="checkbox"/> 安全/環境対策 <input type="checkbox"/> 生産(作業)性向上 <input type="checkbox"/> その他()	・パワーモジュール ・照明機器 ・ウェアラブル製品 ・小型医療機器				
従来	新技術・新工法				
【ワイヤーボンディング方式】  <p>PCB 電極 ベアチップ (フェイスアップ) PCBパターン 金線</p>	【フリップチップボンディング方式】  <p>バンパ(金orはんだ) ベアチップ (フェイスダウン)</p> <p>実装に必要なスペース大幅削減可能</p>				
セールスポイント(製造可能な精度/材質等)	問題点(課題)と対応方法				
・従来方法より実装スペース大幅削減可能 ・設計選択肢拡大(小型化・高機能化など) ・省スペース化のみならず実装高さも低く出来る ・C4実装による接続信頼性	・特になし				
開発進捗 (2018年 12月 現在)	特許の有無				
<input type="checkbox"/> アイデア段階 <input type="checkbox"/> 試作/実験段階 <input type="checkbox"/> 開発完了段階 <input checked="" type="checkbox"/> 製品化完了段階	無				
従来との比較	項目	コスト	質量	生産/作業性	その他()
	数値割合	-	30%削減	-	-